



2008年1月31日

各 位

東京都中央区新川二丁目27番1号
住友化学株式会社
社 長 米 倉 弘 昌
(コード番号：4005 東証・大証第1部)
問合せ先：執行役員コーポレートコミュニケーション部長 下田 尚志
(TEL:03-5543-5102)

子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、2008年1月31日開催の取締役会において、2008年4月1日を期して、当社の100%子会社である住化エレクトロニクス株式会社を下記のとおり吸収合併することを決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

- (1) 住化エレクトロニクス株式会社は、化合物半導体関連材料であるMOIエレクトロニクスの製造・販売を担う会社であり、2003年3月に当社100%子会社として営業を開始いたしました。
- (2) 住化エレクトロニクス株式会社を当社に吸収合併することで、化合物半導体関連材料事業の一体運営による競争力強化ならびに携帯電話用部材を市場とする製品群との市場・技術動向の情報共有化を図りたいと考えております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程（簡易・略式手続きによる合併）

合併決議取締役会 2008年1月31日

合併契約締結 2008年1月31日

合併契約承認株主総会

住友化学株式会社： 会社法第796条第3項の規定に基づく簡易合併であり、合併承認株主総会は開催いたしません。

住化エレクトロニクス株式会社： 会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併であり、合併承認株主総会は開催いたしません。

合併予定日（効力発生日） 2008年4月1日（予定）

(2) 合併方式

当社(住友化学株式会社)を存続会社とする吸収合併方式で、住化IC°ソリューション株式会社は解散いたします。

(3) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

(2007年3月31日現在)

(1) 商号	住友化学株式会社 (合併会社)	住化IC°ソリューション株式会社 (被合併会社)
(2) 主たる事業内容	化学製品の製造、加工および売買	MOIC°ウイールの製造および販売
(3) 設立年月日	大正14(1925)年6月1日	昭和63(1988)年7月1日
(4) 本店所在地	東京都中央区新川二丁目27番1号	東京都中央区新川二丁目27番1号
(5) 代表者	社長 米倉 弘昌	代表取締役 中島 英人
(6) 資本金	89,699 百万円	1,300 百万円
(7) 発行済株式総数	1,655,446,177 株	130 株
(8) 純資産	1,030,521 百万円(連結)	406 百万円
(9) 総資産	2,324,906 百万円(連結)	1,012 百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主および 持株比率	1. 日本トラスティ・サービス 信託銀行 6.68% 2. 日本スタートラスト 信託銀行 6.42% 3. 住友生命保険 4.89% 4. 日本生命保険 3.72%	住友化学 100%

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。

5. 合併による業績への影響の見通し

本合併による連結業績ならびに単体業績への影響は軽微であります。

以上